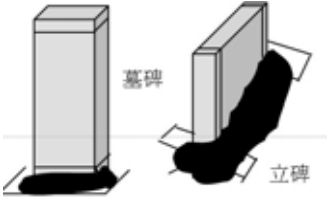
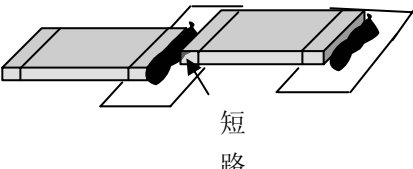
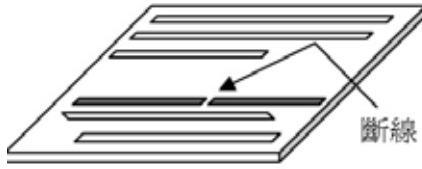
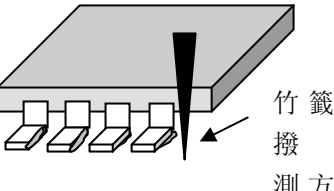
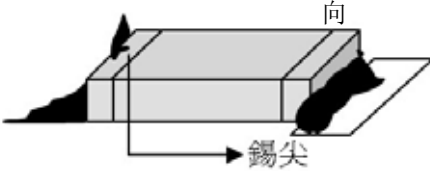
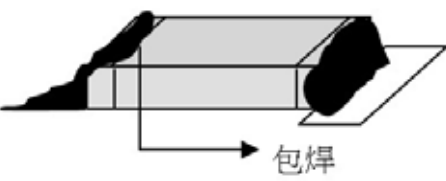
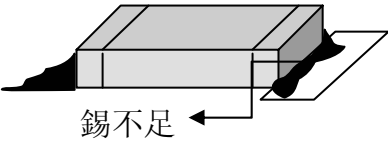
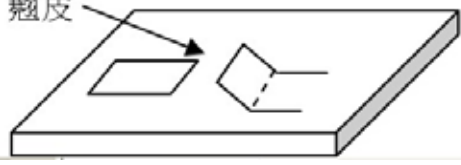
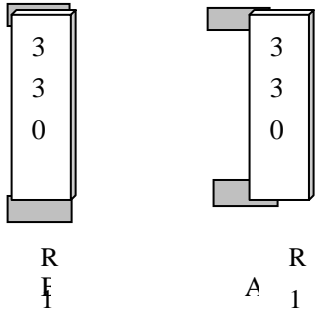
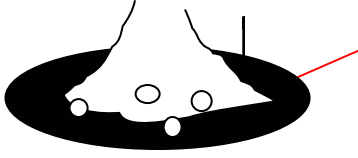
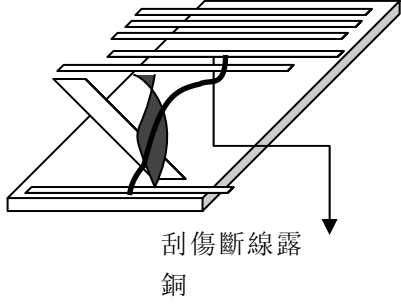


1. SMT 组装作业				
序号	现象	不良描述	示意图	判定
1.1	缺件	PCB 板位置应有零件而未置放零件		MA
1.2	错件	不符合 BOM 的料号或厂牌. 位置错误		MA
1.3	多件	PCB 板位置不应有零件而有多余之零件		MA
1.4	反向	正负极性相反. 零件方向错误		MA
1.5	零件破损	(A) 伤及零件本体或破损影响电性功能		MA
		(B) 未伤及本体或破损不影响电性功能		MI
1.6	空焊	零件的 PIN 未沾附锡之现象		MA

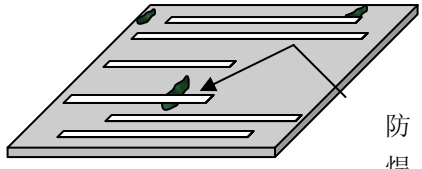
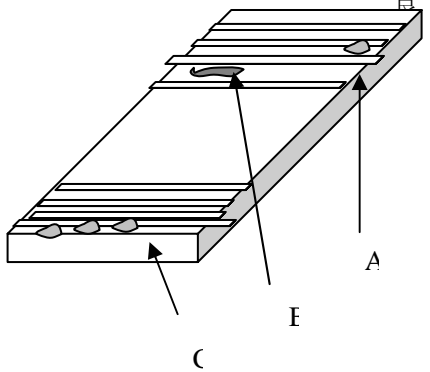
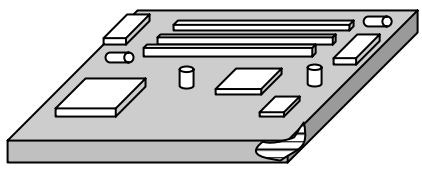
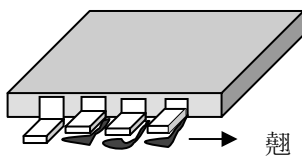
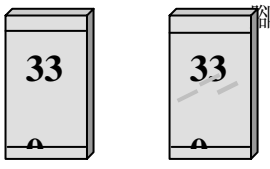
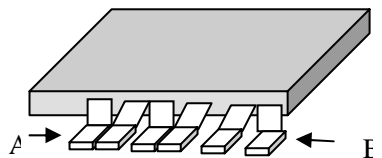
1.7	(A)墓碑	(A)零件一头翘起与PAD单边接触		MA
	(B)立碑	(B)零件因该正面平放而变成侧面平放		MI
1.8	短路	不应导通而导通包含锡渣(球). 锡桥(丝)或残留之导体等形成的短路		MA
1.9	断路	因导通而未导通如PCB板线路断线之现象		MA
1.10	冷焊	零件PIN表面虽有沾锡但附着强度不够可用竹签拨测检验PIN有无脱落现象		MA
1.11	锡尖	超过 1.0 mm 以上不允许 (包含水平状与垂直状形成的锡尖)		MI
1.12	包焊	锡延伸至零件顶部上方,导致零件与PAD焊接轮廓无法辨识		MI

1.13	錫不足	(A)焊錫高度低於焊墊 50% (B)錫表面缺點(不吃錫.氧化拒焊)不得超過 50%		MI
1.14	焊墊翹皮	作業不慎或其它因素造成 PCB 損傷導致線路.焊墊(點)翹起(修補後可接受)		MA
1.15	位移(偏移)	(A)左右偏移大於零件焊墊 長度 50%		MI
		(B)上下偏移,但焊墊尚保 有其零件寬度 20%		MI
1.16	針孔	<b>1.三倍以內放大鏡一目視可見之錳洞/針孔</b>		<b>MA</b>
		<b>2.錳洞/針孔不能貫穿過。</b>		<b>MI</b>
1.17	刮傷	(A)刮傷長度(所有刮痕相加)超過 7cm(未露銅)		MA
		(B)刮傷長度(所有刮痕相加)低於 7cm(未露銅)		MI
		(C)刮傷及線路(露銅)		MA


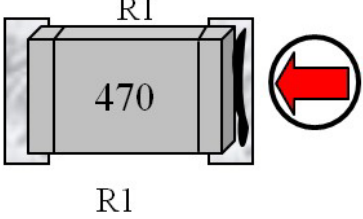
1.18	锡球(渣)	(A)固定不脱落之锡球直径大于 10mil (0.25mm) (B)未固定可能掉落之锡球直径大于 5mil(0.125mm)		(A)MI (B)MI
1.19	孔塞	因制程或其它因素造成零件孔.螺丝孔等孔塞		MA
1.20	不洁	PCB 板面或零件有油污(墨).白斑(雾).水纹和残留水(油)性松香未清洗干净		MI
1.21	残留异物	(A)板上残留可能会危害电气功能之异物如铁脚.锡渣...等		MA
		(B)板上残留异物,不会导通危害电气功能等		MI
1.22	焊点氧化(腐蚀)	未清洗干净造成锡点灰暗或产生铜绿发霉现象		MA
1.23	板弯(翘)	PCB 板经回焊炉.锡炉...等制程造成板弯(翘)之现象其高度不可超出板厚 1 倍 . 例如:板厚 1.6mm 标准不得超过 3.2mm		MI
1.24	PCB 层间剥离	(A)直径大于 3mm 之圆状剥离(起泡) (B)起泡处超过 2 处 (C)起		MA

24H 服务热线:013823590218

E-mail:wdfhktw@wdfhktw.com [Http://www.wdfhktw.com](http://www.wdfhktw.com)

		泡位于 CPU 及 BGA 处		
1.25	PCB 防焊漆不良	PCB 经烘烤后造成防焊漆变色或破裂脱落...等现象其面积不得超过 2*2mm		MI
1.26	PCB 沾锡	(A)沾锡于两条线路上,有短路之虑		MA
		(B)沾锡呈尖锐状或脱落造成短路之虑		MI
		(C)沾锡区域超过 3 处		MI
1.27	PCB(撞伤)	(A)伤及线路或螺丝固定孔 (B)撞伤面积大于 5mm <sup>2</sup>		(A) MA (B) MA
1.28	SMD 零件脚浮高	(A)QFP 零件浮高大于 PIN 脚厚度(B)电阻电容浮高大于 0.5mm		MI
1.29	组件不良	因来料不良所造成的现象如 PCB 来料刮伤,文字面印刷不清... 等		MI
1.30	零件变形	零件严重变形影响电气功能如 CHIPS PIN 变形造成短路等		MA

		零件变形,但并不会影响电气功能		MI
1.31	字体反向	电阻表面标示之阻值数朝下无法确认是否正确		MI
1.32	印刷不良	(A)PCB 或零件印刷模糊无法辨识 (B)PCB 或零件印刷错误.漏印		MI
1.33	CHIPS(SOIC) 偏移	(A)PIN 脚(上下)突出焊垫 (B)PIN 脚(左右)偏移大于PIN 脚宽度 1/3		MI
	零件沾锡	零件修补,制程不慎...等因素造成零件面沾附锡之现象		MI
1.35	混板(料)	机种,工令,料件未依客户通知或制令...等规定区分清楚而混在一起		MA
1.36	未入定位 (SMT 焊盘位)	零件未完全放(插)置于正确位置或孔位		MA

1.37	零件撞落	拿板,放板,搬运...等过程中碰撞使零件掉落造成掉件之现象		MA
1.38	不明标签	修改(补)前所贴的标示于修改(补)完成后未撕掉		MI